



即时发布:

先进封装是每个人的事

摘自:《先进包装产业发展现状》, 2019年

[SYNAPS 2020](#) – 由华进& Yole Développement 共同组织的半导体先进封装研讨会将于 2020 年 3 月 31 日至 4 月 1 日在中国苏州举办

法国里昂- 2019 年 12 月 12 日: “半导体供应链的变化、商业模式的转变以及美中贸易的不确定性, 为一些企业创造了巨大机遇, 同时也对其它企业构成了威胁。” [Yole Développement](#) (以下简称“Yole”) 半导体与软件部门总监 Emilie Jolivet 评论道, “Yole 持续关注先进封装产业, 全面了解市场问题和技术挑战。先进封装工艺是当今所有半导体制造工艺的核心。对所有半导体公司而言, 先进封装技术在应对由 5G、人工智能和物联网等大趋势直接影响的行业发展方面具有战略意义, 并能确保其业务的发展。”

2018-2024 advanced packaging revenue forecast Split by platform

(Source: Status of the Advanced Packaging Industry 2019 report, Yole Développement, 2019)



YOLE
Développement

© 2019 | www.yole.fr - www.ncapchina.com

Yole 在其[先进封装行业报告](#)中称, 2024 年市场规模为 440 亿美元, 2018 年至 2024 年的复合年增长率为 7.9%。

在此动态环境下、第五届活动成功举办后一年, 市场调研&策略咨询公司 Yole 及其合作伙伴华进半导体 (NCAP China) 很高兴宣布由双方合作举办的先进封装及系统集成

成技术研讨会正式更名为 SYNAPS。

在成功举办 5 届活动后, Yole 和华进半导体将在技术委员会的支持下, 向先进封装行业呈现一场激动人心的 SYNAPS 2020。今年, SYNAPS 技术委员会的成员包括: BroadPak 总裁兼首席执行官 Farhang Yazdani、FormFactor 企业并购首席营销官兼高级副总裁 Amy Leong、汉高半导体封装市场全球负责人 Ram Trichur、华进

半导体技术总监孙鹏博士、Yole 韩国首席分析师兼封装、组装和基板业务总监 Santosh Kumar 等。

SYNAPS 2020 是全球唯一一场致力于先进封装行业、先进封装技术及其应用的专业研讨会。研讨会将于 3 月 31 日至 4 月 1 日在中国苏州举行。在两天的会期中，Yole 和 NCAP China 将帮助您了解新鲜的技术和挖掘全新的商机。

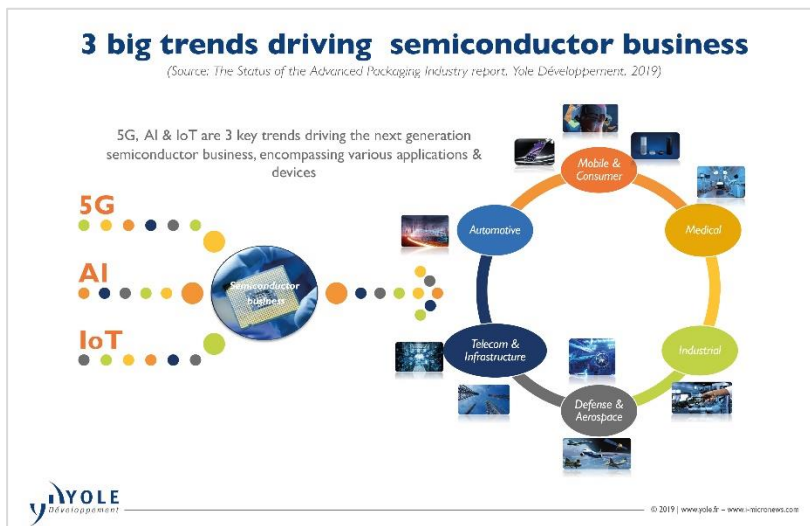
访问 [SYNAPS](#) 会议官网，了解赞助方案并投递论文。现在就预留时间吧！

面对不断变化的目标及大趋势的影响，半导体公司正在调整各自战略。毫无疑问，半导体供应链及其背后的先进封装行业也在经历着不同层次的变革。

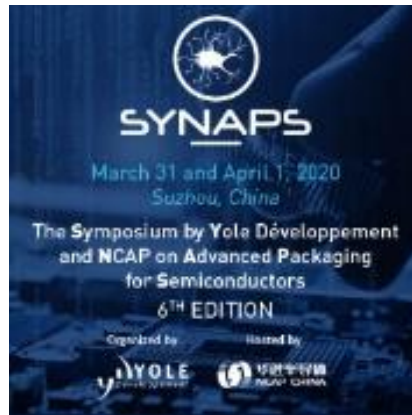
一些厂商已经成功涉足新的商业领域，显著影响 IC 制造链，而其他厂商则未成功。

不同的厂商有不同的驱动因素迁移或拓展新业务——例如谷歌、微软、Facebook 和阿里巴巴这些软件公司正在设计自己的处理器，以便在组装层面获得系统级集成/定制和供应链控制。

最大的变化是代工厂涉足先进封装业务。尽管他们是该领域的新人，但带来的影响是显著的：



- 台积电在扇出和 3D 先进封装平台方面处于领先地位，提供各种产品，如 InFO(及其变种)、CoWoS、WoW、3D SoIC 等。对于台积电来说，先进封装已经成为一项成熟的业务，预计 2019 年其先进封装业务的营收将达到 30 亿美元，在 OSATs 中排名第四。



- 联华电子是 2.5D 封装硅转接板的主要供应商。联华电子最近与 Xperi 合作，为各种半导体器件优化并商业化 ZiBond 和 DBI 技术。
- 武汉新芯为图像传感器和高性能应用提供了 3D IC TSV 封装方案。

总的来说，这些厂商有助于将封装从基板转移到硅平台。其实，不止代工厂进入先进封装领域，IC 基板和 PCB 制造商，如 SEMCO、Unimicron、AT&S 和 Shinko，正通过板级扇出封装和有机基板中的嵌入式芯片（无源元件）涉足先进封装领域。

“这些公司正在瓜分 OSAT 的市场，特别是涉及先进封装业务。” Yole 技术&市场分析师 Favier Shoo 指出，“为了保持竞争力我们将看到未来几年 OSAT 行业出现很多并购交易：大企业合并、2 家具有互补性业务的中型企业并购（如纯粹的封装测试厂商之间）和大企业收购小规模 OSAT（或晶圆级封装企业）。像 Deca Technologies 和 LB Semicon 这样的利基 WLP 厂商是极具吸引力的并购对象。”（详见由 Yole 提供的[2019OSAT 排名](#)）

美国和中国之间的贸易紧张局势可能会影响半导体行业的增长，给供应链带来不确定性。目前，情况仍然不明朗，有很多可能。

“这取决于是否爆发全面贸易战，或者是否达成新的贸易协议，或者双方都做出让步，亦或维持现状。”来自 Yole 的 Santosh Kumar 提到。

SYNAPS 是 2020 年不容错过的活动。

2020 SYNAPS 在具有创新活力的先进封装生态系统——苏州举办。活动将融合先进封装产业创新及变革相关的关键技术，为观众和先进封装领域专家、管理人员提供充裕的社交时间。Yole, 华进半导体

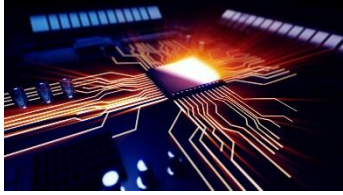
和技术委员会将发挥各自的技术和市场优势，呈现一场激动人心的活动。

华进半导体总经理曹立强博士表示：“华进半导体承载着促进中国先进封装技术高速发展的使命，我们同 Yole 已成功举办 5 届研讨会，并将继续全力支持。我们坚信，拥有多年积累和沉淀的 SYNAPS，在技术委员会的帮助下，2020 年必将取得成功。千万不要错过了解最新的技术趋势和在中国扩展业务的机会”

Yole 的 Emilie Jolivet 表示：“随着功能越来越多，企业必须进行创新。他们必须管理自己的能力，在一个芯片上集成越来越多的元件，并提供高可靠性的最终产品。我们诚挚邀请您参加 SYNAPS 2020，深入了解先进封装，了解创新技术，并探索新的商机。”

现在就预留时间吧！2020 年 3 月 31 日，中国苏州，不见不散！

关于 2019 年先进封装系列报告：



先进封装行业发展趋势

尽管半导体行业发展放缓，先进封装市场仍保持增长，2018 年-2024 年年复合增长率 8%。

报告涉及企业：

Altera, Amkor, Analog Devices, Ardentec, Atmel, AOI Electronics, Apple, ARM, ASE, Avago, Broadcom, Carsem, China WLCSP, Chipbond, ChipMOS, Cisco, Cypress Semiconductor, Deca Technologies, Greteck, IC Interconnect, Fairchild, Facebook, Flip Chip International, Formosa, Freescale, Fujitsu, GLOBALFOUNDRIES, Google, Hana Micron, Huawei, Inari Berhad and more ...

其他相关报告：

- 汽车封装：市场及技术趋势： 汽车的自动化和电气化正在促进先进封装行业的增长。
- 贴片设备市场现状： 不断增长的业务和新的技术挑战稳固贴片设备市场。
- 扇出封装设备及材料： 电子封装设备和材料的业务增长高度依赖于大公司的投资，需要全新的杀手级应用助推增长。
- 先进基板产业现状： 新数字时代的需求正在唤醒沉睡的基板巨人。
- 扇出封装：技术和市场趋势： 三星和力成携板级封装进入“扇出”战场。
- 2.5D / 3D TSV 和晶圆级堆叠：技术和市场现状： 2.5D 异质集成和 3D 晶圆级堆叠正在重塑封装产业。

关于华进半导体

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司作为江苏省无锡市落实中央打造以企业为创新主体的新创新体系典型，在江苏省/无锡市政府、国家 02 重大专项与国家封测产业链技术创新战略联盟的共同支持下于 2012 年 9 月在无锡新区正式注册成立。公司是由中科院微电子所和集成电路封测产业龙头企业长电科技、通富微电、华天科技、深南电路 5 家单位共同投资而建立。后又新增苏州晶方、安捷利（苏州）、中科物联、兴森快捷、国开基金五家股东。到目前共有十家股东。

公司作为国家级封测/系统集成先导技术研发中心，通过以企业为创新主体的产学研用结合新模式，开展系统级封装/集成先导技术研究，研发 2.5D/3D TSV 互连及集成关键技术（包括 TSV 制造、凸点制造、TSV 背露、芯片堆叠等），为产业界提供系统解决方案。同时将开展多种晶圆级高密度封装工艺与 SiP 产品应用的研发，以及与封装技术相关的材料和设备的验证与研发。

更多信息，请访问 www.ncap-cn.com。

关于 Yole Développement

Yole Développement 成立于 1998 年，现已发展成为一家集市场营销、技术和战略咨询、媒体和企业财务服务、逆向工程和逆向成本服务以及知识产权和专利分析为一体的企业集团。重点关注使用硅和/或微制造新兴应用，Yole 集团全球合作者超 80 名，业务覆盖 MEMS & 传感器、成像、医疗技术、复合

半导体、射频电子、固态照片、显示、光电、电力电子、电池及能源管理、先进封装、半导体制造、软件和计算、存储.....

作为一家市场调研、技术和战略咨询公司，Yole Développement 及其合作伙伴 System Plus Consulting、PISEO 和 KnowMade 为全球的企业、投资者和研发机构提供支持，帮助它们了解市场、跟踪技术趋势并发展业务。

更多信息，请访问 www.yole.fr。